

マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ ～パワーデバイスの信頼性評価～

【 主 催 】

一般社団法人 日本溶接協会
マイクロソルダリング要員認証委員会、マイクロソルダリング要員評価委員会、マイクロソルダリング教育委員会

【 開催日時および会場 】

平成 26 年 10 月 28 日（火） 10：30～16：50 於：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室

【 開 催 趣 旨 】

電子・電気製品を支える実装技術は様々な分野で目まぐるしく変化する新技術を採用した製品が作られており、厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、高い信頼性が求められております。

日本溶接協会では、平成 4 年よりマイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行っており、累計で 2 万人を越える皆様にご活用頂いております。その資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・装置の展示、

最新の技術動向を通じてマイクロソルダリング実装の展開を知って頂く場として、平成 18 年から「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催しております。

本年度は、「パワーデバイスの信頼性評価」をテーマに、これまでの実装関連の変遷、海外での取り組みや最新の情報をご紹介させて頂くことと致しました。事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

【 プ ロ グ ラ ム 】

10:30-10:35	開会の挨拶 マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三
10:35-11:00 (25分)	「マイクロソルダリング技術資格制度の概要と実装工程管理技術者資格の紹介」 (一社) 日本溶接協会 日暮 宏彰
11:00-11:40 (40分)	「車載用パワーデバイスの実装技術」 (株) デンソー 半導体実装開発部 山田 博之
11:40-12:25	展 示 品 紹 介 (5分程度/1社)
12:25-14:05	昼 食 休 憩 ・ 展 示 見 学
14:05-14:25	マイクロソルダリング技術賞 表彰式
14:25-15:05 (40分)	「車載電子機器・電子デバイスの信頼性評価試験」 エスベック(株) テストコンサルティング本部 高橋 邦明
15:05-15:25	休 憩 ・ 展 示 見 学
15:25-16:05 (40分)	「車載電子機器用ソルダリング材料とその実装信頼性」 (株) ニホンゲンマ 技術部 濱田 好人
16:05-16:45 (40分)	「車載電子デバイス実装における実装材料の信頼性評価」 群馬大学 大学院 理工学府 知能機械創製部門 荘司 郁夫
16:45-16:50	閉会の挨拶 マイクロソルダリング教育委員会 委員長 佐藤 武彦

※ プログラムの題目・内容は変更になる場合があります。予めご了承願います。

なお、最新詳細情報はホームページ「<http://www.jwes.or.jp/ms/>」を参照願います。

<< お手数ですが、関係各所に回覧をお願い申し上げます。 >>

【 参加申込方法 】

本紙下部の申込書(コピー可)に必要事項を記入し、下記申込先にFAXにて平成26年10月17日までにお送り下さい。受付後、折り返し参加票をFAXにて送付致します。フェスタ当日は、必ず会場受付まで参加票をお持ち下さい。参加票をお持ちでは無い方は、ご入場をお断りする場合がございます。

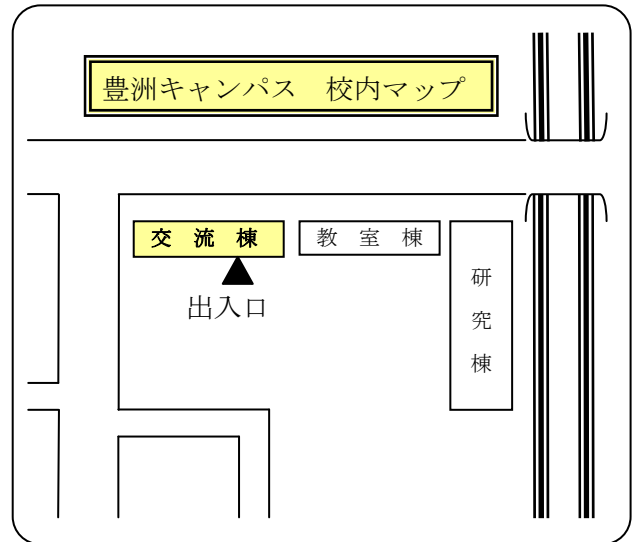
会 場 : 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室 (〒135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5)

参加定員 : 400名 (先着順、定員になり次第締切り)

参加費用 : 無 料

お申込先 : (一社)日本溶接協会 担当 : 日暮、田川 (TEL : 03-5823-6325 FAX : 03-5823-5211)

【 会場案内図 】



FAX : 03-5823-5211 一般社団法人 日本溶接協会

マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ 事務局 宛

<<参加申込書>>

ふりがな		
氏名	(姓)	(名)
ふりがな	ふりがな	
勤務先 (所属先名)	電話番号 ()	FAX ()
同 上 所在地	〒	
E-mail		

※ 複数のお申し込みの場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。